

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THAM GIA TRIỂN LÃM CHIP BÁN DẪN VÀ ỨNG DỤNG



Bên lề chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 14/4/2023, Viện Công nghệ Thông tin đã tham gia Triển lãm chip bán dẫn và ứng dụng với nhiều sản phẩm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của các bộ ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học.

Bên cạnh những đóng góp trực tiếp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, xuất bản hàng trăm công trình báo khoa học và đăng ký nhiều bản quyền sở hữu trí tuệ, nhóm nghiên cứu Hệ

thống tích hợp thông minh đã phát triển được một số sản phẩm nổi bật liên quan tới công nghệ bán dẫn có tính thương mại hóa cao như: Vi mạch mã hóa tín hiệu video theo chuẩn tiên tiến H.264/AVC (VENGME); Vi mạch thu phát IoT bằng tần kép ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (IoT-A); Vi mạch bảo mật hạng nhẹ cho IoT (SNACK); Vi mạch bảo mật cho thẻ RFID; Vi mạch và thiết bị IoT an toàn dùng trong đô thị thông minh (ADEN4IoT)... Sản phẩm vi mạch bảo mật dữ liệu cho hệ thống IoT, được nhóm nghiên cứu Hệ thống tích hợp

thông minh thiết kế, mô phỏng và xây dựng ứng dụng IoT bằng cách nối đi chế tạo tại TSMC Đài Loan trên công nghệ 65nm. TS. Bùi Duy Hiếu, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, cho biết nhóm sử dụng vi mạch sau khi chế tạo gắn trên bo mạch để kiểm tra hoạt

động và xây dựng ứng dụng IoT bằng cách nối thêm các sensor và bộ thu phát vô tuyến. Nhóm đã xây dựng một ứng dụng thử nghiệm để đo đạc các thông số môi trường như bụi mịn, các khí độc hại, nhiệt độ, độ ẩm. [Xem thêm](#)

